思泰克 S8080 系列/国产最好的 SPI



- 一、S8080 系列产品描述及规格:
- 1、可编程相位调制轮廓测量技术(PSLM PMP):思泰克发明专利,其 独创的可编程结构光栅使用软件即可

对光栅的周期进行设置;取消了机械驱动及传动部分,大大提高了 设备的精度及适用范围,避免了机械磨损

和维修成本。实现对 SMT 生产线中精密印刷焊锡膏进行 100%的高精度三维测量。

2、思泰克专利同步结构光技术解决了锡膏三维检测中的阴影效应干扰。结合 RG 二维光源完美处理高对比度的

基板,如黑色基板,陶瓷基板等。采用红、蓝、绿三色光,可提供彩色 **2D** 图像;

3、高解析度图像处理系统:超高帧数 400 万像素工业 CCD 相机,配合高端镜头,支持对 01005 锡膏的快速稳定

检测。同时提供 10um、15um、18um、20um 等多种不同的检测精度,配合客户的产品多样性和检测速度的要求;

4、快速 Gerber 导入及编程软件,可实现业内最快的 5 分钟编程; 人工 Teach 功能方便使用者在无 Gerber 数据时

的编程及检测;

5、Z轴实时动态仿形: PSLM 的特点提供了对 PCB 的翘曲变化进行实时动态跟踪,完美解决柔性线路板和 PCB

翘曲问题。

6、强大的过程统计分析功能(SPC):实时 SPC 信息显示,完整 多样的 SPC 工具,让使用者实时监控生产中

的问题,减少由于锡膏印刷不良造成的缺陷。提供给操作人员强有力的品管支持,让使用者一目了然;

7、设备重复性精度<<10% (6 Sigma)。

二、设备软硬件配置:

技术参数/Parameters	
产品定位 Product	高性价比机型 Cost-Effective Model
Describtion	
产品系列 Series	S8080
测量原理 Measurement	3D 白光 PSLM PMP (可编程结构光栅相位调制轮
Principle	廓测量技术,俗称摩尔条纹技术)
	3D white light PSLM PMP(Programmable
	Spatial Light Modulation,commonly known as
	moire fringe technology)
测量项目 Measurements	体积,面积,高度,XY偏移,形状(volume,acreage,
	height , XY offset, shape)
检测不良类型 Detection	漏印、少锡、多锡、连锡、偏位、形状不良、板面
of Non - Performing	污染
Types	(missing print,insufficient tin, excessive tin,
	bridging, offset, mal-shapes, surface
	contamination)
相机像素 Camera Pixel	4M
镜头类型 Lens Types	长焦镜头 telephoto lens
镜头解析度 Lens	20um,18um/22um as option
Resolution	
视野尺寸 FOV Size	40×40mm
精度 Accuracy	XY 解析度(XY Resolution):1um;高度(Height):
	0.37um
重复精度 Repeatability	eight:≤1um (3 Sigma);
	volume/acreage:<1%(3 Sigma);

检测重复性 Gage R&R	小于 10%(<10%)
FOV 速度 FOV Speed	0.45s/FOV
检测头数量 Quantity of	Single Head
Inspection Head	
红绿蓝/RGB 三色光	标配 standard configuration
源 Red Green	
Blue/RGB Three Colas	
Option Light Source	
基准点检测时	0.5sec/piece
间 Mark-point	
Detection Time	
Z轴实时升降补偿板弯	标配 standard configuration
Compensation Plate	
Bending of Real-time Lift	
in Z-axis	
最大检测高	±350um
度 MaximunMeauring	
Height	
弯曲 PCB 最大测量高度	±3.5mm
Maximun Measuring	
Height of PCB Warp	
最小焊盘间	200um (pad height of 150um as the reference)
距 Minimum Pad	
Spacing	
最小测量大	长方形(rectangle):200um;圆形(round):250um
Size	
最大 PCB 载板尺	L460xW460mm [,] L500mm as option
寸 Maximum Loading	
PCB Size	
PCB 板厚度 Thickness	0.4-5mm
of the PCB	
零件高度限制 Height	up:30mm down:40mm
Limitations of the Parts	
板边距 Board Edge	3mm ,可选万能夹边 multifunctional
Distance	clip edge as option
定动轨设置 Flixble or	前定轨(后定轨*选件)front orbit (back orbit as
Fixed Orbit Setting	option)

Transfer Direction 轨道宽度调整 Orbit 手动,可选自动 (manual , automatic as option) Width Adjustment SPC 统计数据 SPC Histogram; Xbar-R Chart; Xbar-S Chart; Statistics CP&CPK %Gage Repeatability Data; SPI Daily/Weekly/Monthly Reports
Width Adjustment SPC 统计数据 SPC Statistics Histogram; Xbar-R Chart; Xbar-S Chart; CP&CPK %Gage Repeatability Data; SPI
SPC 统计数据 SPC Statistics Histogram; Xbar-R Chart; Xbar-S Chart; CP&CPK %Gage Repeatability Data; SPI
Statistics CP&CPK %Gage Repeatability Data; SPI
Daily/Meekly/Monthly Penorts
Daily/Weekly/Working Nepolts
Gerber 和 CAD 导 支持 Gerber 格式 (274x,274d)(support Gerber
入 Gerber & CAD Data format);人工 Teach 模式 (manual Teach
Imput model);CAD X/Y,Part No.,Package Type 等
导入 (CAD X/Y [,] Part No. [,] Package Type imput)
电脑类型 Computer 戴尔电脑 DELL computer
Types
电脑配置 中央处理 Intel 4-core
Computer 器 CPU
Configuration 内 24G
存 RAM
图像处理 1G discrete graphics
器 GPU
硬 1T
盘 Hard
Disk
DVD+RW standard configuration
Operating Windows 7 Professional (64 位 64 bit)
System
设备规格 Equipment
Diemension and Weight
电源 Power 220V、10A
气压 Air Pressure 4~6Bar
功率(启动/正常)Power 启动 start:2.5kw / 正常运转 normal
(Start / nornmal) operation : 2kw
地面承重要求 Loading 600kg/m²
Requirements of the
Floor
选配件 Options 万能夹边、相机条码、1D/2D Barcode 扫描枪、
Badmark 功能、印刷机闭环控制、维修工作站、UPS
不间断电源、超声波感应器

multifunctional clip edge,Camera Barcode, 1D
2D Barcode scanner, Badmark function, print
closed-loop control,Rework Station, UPS
continuous power supply \(\cdot \text{ultrasonic sensor} \)